



Title of Change:	Assembly and Final Test Site Transfer from HANA Semiconductor to Carmona(PH1) for FAN7191MX-F085, FAN7171MX-F085 and FAN7171M-F085.
Proposed Changed Material First Ship Date:	06 Oct 2021 or earlier if approved by customer
Current Material Last Order Date:	31 Mar 2021 <i>Orders received after the Current Material Last Order Date expiration are to be considered as orders for new changed material as described in this PCN. Orders for current (unchanged) material after this date will be per mutual agreement and current material inventory availability.</i>
Current Material Last Delivery Date:	05 Oct 2021 <i>The Current Material Last Delivery Date may be subject to change based on build and depletion of the current (unchanged) material inventory</i>
Product Category:	Active components – Integrated circuits
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Hyunkyung.Park@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or <PCN.samples@onsemi.com> . Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Sample Availability Date:	30 Sep 2020
PPAP Availability Date:	20 Oct 2021
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Rhica.Loredo@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 12 months prior to implementation of the change or earlier upon customer approval. ON Semiconductor will consider this proposed change and it's conditions acceptable, unless an inquiry is made in writing within 45 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com .
Change Category	
Category	Type of Change
Test Flow	Move of all or part of electrical wafer test and/or final test to a different location/site/subcontractor
Process - Assembly	Move of all or part of assembly to a different location/site/subcontractor., Change of mold compound, Die attach material, Change of direct material supplier, Change of encapsulation/sealing material, Change of product marking



Description and Purpose:

	Before Change Description	After Change Description
LeadFrame Supplier	HDS	ASM
Die Attach	PN 400720 DA ADHESIVE QMI519	PN H00144A065/A DA ADHESIVE SUMITOMO CRM-1076WB
Bond Wire	PN 500032T Au 1.0mil	PN B24082A003 Au 1.0mil
Mold Compound	PN 45038 HENKEL GR828FC1 16mmx11g	PN N53479E013 SUMITOMO EME G700LS 16mmx10.1g
Assembly Site	HANA	OSPI-CARMONA
FT Site	HANA	OSPI-CARMONA

	From	To
Product marking change	Line1: \$Y&Z&2&K Line2: FAN Line3: 7191	Line1: FAN7191 Line2: A(YWW)

Reason / Motivation for Change:

Quality improvement
 - No Risks
 - For the Assembly, MSL3 with Delamination performance improved

Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability

The device has been qualified and validated based on the same Product Specification. The device has successfully passed the qualification tests. Potential impacts can be identified, but due to testing performed by ON Semiconductor in relation to the PCN, associated risks are verified and excluded.
 No anticipated impacts.

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites

ON Semiconductor Carmona, Philippines

External Foundry/Subcon Sites

None

Marking of Parts/ Traceability of Change:

The affected products will have a standard marking from OSPI as below.
 Line1: FAN7191
 Line2: A(YWW)

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME : FAN7191MX-F085
 RMS : U62060
 PACKAGE : SO8

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	2016 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016hrs	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/231
THBT	JESD22-A110	85°C, 85% RH, bias	1008hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	3 IR @ 260 °C		
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30

**NOTE: AEC-1pager is attached.**

To view attachments:

1. Download pdf copy of the PCN to your computer
2. Open the downloaded pdf copy of the PCN
3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field
4. Then click on the attached file/

Electrical Characteristic Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Current Part Number	New Part Number	Qualification Vehicle
FAN7191MX-F085	FAN7191MX-F085 (No change)	FAN7191MX-F085
FAN7171MX-F085	7171MX-F085 (No change)	FAN7191MX-F085
FAN7171M-F085	7171M-F085 (No change)	FAN7191MX-F085

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22826Z

発行日: 05 Oct 2020

変更件名:	FAN7191MX-F085、FAN7171MX-F085、FAN7171M-F085 の組立および最終検査拠点を HANA セミコンダクターからカルモナ (PH1) へ移管
初回出荷予定日:	06 Oct 2021 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)
現在の材料の最終注文日:	31 Mar 2021 既存品の最終注文日以降の注文は、この PCN に記載されている変更後品の注文とみなされます。この日付より後の既存品(変更前品) u の注文は、相互契約により変更前品の在庫状況に応じて履行されます。
現在の材料の最終出荷日:	05 Oct 2021 既存品 (変更前品) の最終出荷日は、変更前品の製造および在庫の状況によって変更されることがあります。
製品カテゴリ:	アクティブなコンポーネント – 集積回路アクティブなコンポーネント – 集積回路
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Hyunkyung.Park@onsemi.com > にお問い合わせください。
サンプル:	サンプルの注文または < PCN.samples@onsemi.com > を注文するには、お近くの ON Semiconductor 営業所にお問い合わせください。 サンプルのリクエストは、この変更通知の公開後 45 日以内に提出してください。 サンプルの納品時期は、リクエスト日、サンプル数量、特別なお客様の梱包/ラベルの要件に従います。
サンプル提供開始可能日:	30 Sep 2020
PPAP 提供開始日:	20 Oct 2021
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < Rhica.Loredo@onsemi.com > にお問い合わせください。
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。 FPCN は、変更実施の 12 か月前、またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前に発行されることがあります。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 45 日以内に書面による問い合わせが行われない限り、この変更希望およびその条件が受諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com をお願いします。
変更カテゴリ:	変更種別
テストフロー	電氣的ウエハテスト、そして / 或いは最終検査の一部またはすべてを異なる場所 / 拠点 / 外注先に移管
プロセス – 組み立て	組立のすべてまたは一部を異なる場所 / 拠点 / 外注先に移管 モールドコンパウンドの変更、 ダイ接着剤材料、 直材サプライヤの変更、 封入 / 封止材料の変更、 製品マーキングの変更



説明および目的:

	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム サプライヤー	HDS	ASM
ダイ接着剤	PN 400720 DA ADHESIVE QMI519	PN H00144A065/A DA ADHESIVE SUMITOMO CRM-1076WB
ボンドワイヤ	PN 500032T Au 1.0mil	PN B24082A003 Au 1.0mil
モールド・コンパウンド	PN 45038 HENKEL GR828FC1 16mmx11g	PN N53479E013 SUMITOMO EME G700LS 16mmx10.1g
組み立て拠点	HANA	オン・セミコンダクター カルモナ(フィリピン)
最終検査拠点	HANA	オン・セミコンダクター カルモナ(フィリピン)

	変更前	変更後
製品マーキング変更	1 行目: \$Y&Z&2&K 2 行目: FAN 3 行目: 7191	1 行目: FAN7191 2 行目: A(YWW)

変更の理由 / 動機:	<ul style="list-style-type: none"> - 品質改善. - リスクなし - 組立について、MSL3 の剥離性能向上
適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関して見込まれる影響	<p>製品は同じ製品仕様に基づいて認定および検証されています。製品は認定試験に正常に合格しています。潜在的な影響が確認される可能性があります。オン・セミコンダクターが PCN に関して実施する検査により、関連するリスクは検証および排除されます。</p> <p>予想される影響はありません。</p>

影響を受ける拠点:

オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:
オン・セミコンダクター カルモナ(フィリピン)	無し

部品の表示 / 変更の追跡可能性:	<p>影響を受ける製品は、オン・セミコンダクター カルモナ(フィリピン) 標準のマーキングがされます。</p> <p>1 行目: FAN7191 2 行目: A(YWW)</p>
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

信頼性データの要約:

デバイス名: FAN7191MX-F085

RMS: U62060

パッケージ: SO8

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta = 125°C、100% 最大定格 Vcc	2,016 時間	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150°C	2,016 時間	0/231
TC	JESD22-A104	Ta = -65°C ~ +150°C	1,000 サイクル	0/231
THBT	JESD22-A110	85°C、85% RH、バイアス	1008 時間	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C、85% RH、18.8psig、バイアスなし	96 時間	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	260 °C で 3 IR		
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C、10 秒		0/30

**添付文書を見るには:**

1. ご使用のコンピューターに PDF 版の PCN をダウンロードします。
2. ダウンロードした PDF 版の PCN を開きます。
3. 添付欄を見るには、画面左 / 下部分のメニュー上にあるクリップアイコンをクリックしてください。
4. 添付ファイルをクリックします

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号 (既製品) のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールのお客様の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

現在の部品番号	新部品番号	認定試験用ピークル
FAN7191MX-F085	FAN7191MX-F085 (No change)	FAN7191MX-F085
FAN7171MX-F085	7171MX-F085 (No change)	FAN7191MX-F085
FAN7171M-F085	7171M-F085 (No change)	FAN7191MX-F085



Appendix A: Changed Products

D

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
FAN7191MX-F085		FAN7191MX-F085	NA	
FAN7171MX-F085		FAN7191MX-F085	NA	
FAN7171M-F085		FAN7191MX-F085	NA	